



H6380 双组分导热凝胶

产品描述

H6380 是一款双组分，高性能的点胶式导热凝胶，专为满足电子设备高效散热需求而设计。

产品优点：

- 高导热率 8.0W，具有优秀的导热性能
- 宽的规格间隙填充，满足 120um 到 3mm 厚度的导热填缝
- 高挤出率 65g/min，具有良好的可挤出性，便于点胶操作
- 具备优异的长期热稳定性、高可靠性，能承受苛刻的热冲击、冷热循环测试
- 良好的电气绝缘性

典型运用领域：

- 手机通讯设备
- 光纤通讯设备，5G 基站设备
- 汽车电子控制单元（ECU）
- 汽车 LED 芯片与散热器

固化前参数

条目	A 组份	B 组份	备注
外观	灰白色	蓝色	/
混合比例	1:1		体积比
比重 g/cm ³	3.0		ASTM D70-97
挤出速率 g/min	65	65	ASTM D2452-94
可操作时间 min	180		@25℃

固化后参数

在推荐的条件下固化：

条目	典型值	备注
硬度 Shore 00	58	ASTM D2240
导热系数 W/m.k	8.0	ASTM D5470



热阻°C.cm ² /W	0.18	ASTM D5470@40psi
BLT (粘接厚度)um	120	ASTM D5470@40psi
耐压强度 kv/mm	≥9.0	ASTM D150
体积电阻率 Ω • cm	≥1.0×10 ¹³	ASTM D257
阻燃特性	V-0	UL 94
RoHS	符合	/
连续使用温度 °C	-45~ 200	/

固化条件

条目	典型值	备注
固化	60 分钟	@80°C
	24 小时	@25°C

这是胶粘剂上的温度达到指定温度后的时间。以上固化时间仅是推荐的指南。固化条件（时间和温度）应依据客户经验、应用要求、固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

使用指南

点胶：配合混合针管，使用点胶机或胶枪即可点胶在需使用位置；桶装组合按照 1:1 比例，将 B 组份加入到 A 组份中混合均匀，然后再通过点胶 / 涂抹 / 印刷等装配方式使用在设计位置；

固化：将组件装备好后室温或加热固化。冬季若固化时间太长时，建议采用加热固化方式。

注意事项

有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料。

标准包装

- 10ml , 30ml , 50ml / 支
- 36L/组：A组份 18L/桶，B组份 18L/桶
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。



本产品最佳存储条件：5~25℃，存储期 12 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com